

1. 안건 개요

- (추진 배경) 반도체 분야 ASML社와 같이 압도적 기술역량으로 공급망 재편 과정에도 배제되지 않는 기업을 육성하기 위해 추진('24년부터 선정)

* (근거) 소재·부품·장비 글로벌화 전략('23.4.18 제11차 소재·부품·장비 경쟁력강화 위원회 심의·의결), '24년 소재부품기술개발사업(패키지형 : 슈퍼 을 R&D) 신규지원 예산 심의·확정('24.8.27 사심위 의결)

- (지원 방식) 신청 기업이 제안한 기술개발 계획 및 성장 로드맵을 평가하여 주관기관을 슈퍼 을 기업으로 선정 → Cascading (유연 컨소시엄)* 방식을 적용하여 협력기업과 함께 통합형 패키지 과제 지원

* 주관연구개발 기업을 먼저 선정 후 협약 시 컨소시엄을 자율적으로 구성하는 방식

- (지원 대상) 반도체 등 10대 분야 공급망 핵심 급소기술 개발 기업

2. 신규 슈퍼 을 과제 주요 내용

슈퍼 을 기업명	분야	개발 목표
한화오션	기계 금속	· 잠수함용 연료전지 시스템 장비 및 심해용 합금 배관 개발
선익시스템	디스플레이	· OLED 증착 공정 자율제조 기술 선점 및 원가 절감
이오테크닉스	반도체	· 국부 가열 레이저 어닐링 출력 자동 미세조정 기술로 한계 극복
에코프로비엠	전기 전자	· 황화물계 고체전해질 원료 활용도 향상 및 습식 제조 기술개발
두산전자사업	전기 전자	· 동판 소재 및 적층 기술 개발로 신호 경로 단축 및 방사 성능 강화